

第 21 回半導体・センサ パッケージング技術展



2020年1月15日から17日まで東京ビッグサイトで開催される「第21回半導体・センサ パッケージング技術展」に出展します。

ICやセンサ用途向けの高速度ダイボンダー「BESTEM-D310plus+」を初出展いたします。

ダイボンダーの分野においてあらゆるニーズにお応えできるラインナップをご用意しております。

また、検査能力が更に向上した三次元形状計測装置「BESTEM-V110」や超短パルスレーザー加工装置「Surfbeat R」等、お客様の開発や生産を支えるソリューション提案に繋げる技術や商品のご紹介をさせていただきます。

是非とも当社ブースにお立ち寄りくださいますよう、お願い申し上げます。

開催期間	2020年1月15日(水)～17日(金) 10:00～18:00 (最終日のみ 17:00 まで)	
会場	東京ビッグサイト 西ホール	
当社ブース	W9-20	
交通アクセス	https://www.nepconjapan.jp/ja-jp/visit/access.html	
出展機種	IC・センサ用途向け高速度ダイボンダー BESTEM-D310plus+ 	三次元形状計測装置 (卓上機) BESTEM-V110 
本展示会・製品に関するお問い合わせ： キヤノンマシナリー株式会社 セミコンシステム事業本部 営業部 電話番号：077-566-1822 FAX番号：077-566-1833 E-Mail : cmi-sales-ml@mail.canon		